

技術資料

EP-2005 絕緣接著劑

產品說明：

EP-2005 為單液型環氧樹脂晶片接著劑，主要應用於 Flex-BGA & stacked-die BGA 封裝，可快速硬化，並具有良好之韌性、不溢流及對於不同基板皆有良好黏著性。

產品特徵：

- 平滑、流體且不拉絲之銀膠。
- 低揮發物、不溢膠。
- 低應力。
- 改善 MSL 測試之信賴性。

硬化前特性		測試條件	測試方法
比重	1.4 g/cc	比重計	FT-P001
外觀	紅色		
黏度 @ 25°C	8500 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	4.9	Brookfield DV-III/CP-51 黏度. @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm	FT-P008
使用壽命 @ 25°C	48hrs	黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P024
保存期限 @ -40°C	6 個月		FT-P018
烘烤條件		測試條件	測試方法
標準烘烤條件		60 分鐘 @150°C (烘箱烘烤)或 30 分鐘 @175°C (烘箱烘烤)	
硬化時之熱重損失	<5%		FT-P010
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	≥ 8 kg/die	晶片尺寸 2mm × 2mm (銀支架)	FT-M012
@260°C	≥ 1 kg/die		

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

EP-2005 絕緣膠

物理及化學性質		測試條件	測試方法
重量損失@200°C	0.1%	熱重分析儀	FT-P010
玻璃轉移溫度 (Tg)	47°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數	<Tg 50ppm/°C >Tg 155 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
儲存模數			
@60°C	4532MPa	DMA, 試片厚度<1.6mm	FT-M019
@25°C	1694MPa		
@150°C	101MPa		
@250°C	107MPa		

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

運用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(一般包裝回溫時間 60 鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C~-40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）